

求人票

求人要項 (求人No.SED01)

| | |
|------|--|
| 事業 | 半導体デバイス事業 |
| 職務 | 半導体デバイス製品のFAE(MCU・MPU・アナログ・パワー・FPGA・センサー・各種無線デバイス等) |
| 勤務地 | 大阪本社（大阪市西区）/東日本支社（東京都港区）/中部支社（名古屋市中区） |
| 職務内容 | <p>■半導体デバイス製品のFAE (MCU・MPU・アナログ・パワー・FPGA・センサー・各種無線デバイス等)</p> <p>■具体的には</p> <ul style="list-style-type: none">・半導体製品の製品提案・お客様の開発の技術サポート |
| 応募要件 | <p>【必須】</p> <ul style="list-style-type: none">・半導体製品（MCU・アナログ・センサ・通信・FPGA）の製品提案と技術サポート経験 <p>【歓迎】</p> <ul style="list-style-type: none">・積極性があり、周りに順応できる方 |